2026/9/4

市 場 熱 點

2026 年 Semicon Taiwan

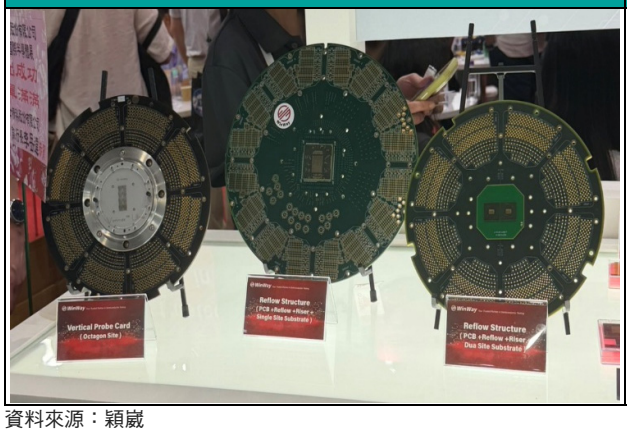
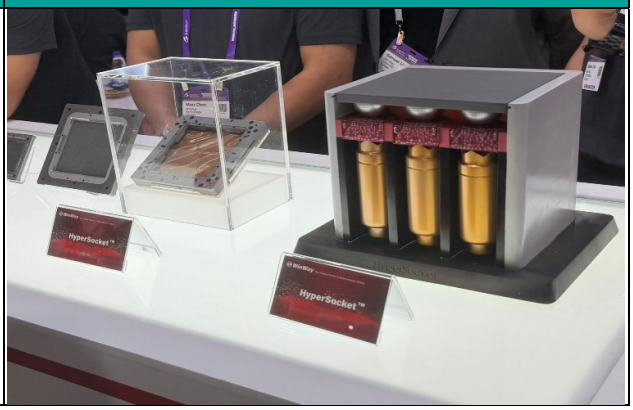
■重點摘要

Semicon Taiwan 2026於9月2日至4日舉辦，今年主軸為「Transform Tomorrow共構未來」。本次展覽展出AI、先進製程、先進封裝、CPO等解決方案，其中因應AI晶片尺寸放大、未來AI模型傳輸效率要求，設備商均積極展出FOPLP、CPO等相關產品，包含家登展出其600*600、510*515mm²之面板級封裝晶圓載具以此因應各家封測廠之尺寸規格，迅得則和日月光密切合作並展出降低大玻璃破損率之上下料機；另在CPO解決方案中，包含萬潤、惠特等均展出其機台，以此搶攻CPO未來市場機會。

■展覽資訊

➢ 穎崴(6515)：持續展出針對AI/HPC領域所開發之Hypersocket

穎崴本次除了展出探針卡、測試基座解決方案外，亦展出近年積極推廣之Hypersocket，其瞄準AI晶片邁向超大尺寸封裝（超過100*100 mm²）、高針腳數(20,000 pin以上)的複雜架構，以此解決測試過程中的翹曲、預壓力均勻分布等挑戰；此外相較於傳統的測試基座透過探針接觸晶片錫球進行測試，長期將對探針產生磨損，Hypersocket則採用複合式彈性橡膠體(Elastomer)之結構，可有效避免對晶片錫球造成損傷及後續可能產生之錫屑，故在清潔維護上也較為方便；惟目前導入客戶端之痛點仍在於價格明顯高於現有之測試基座(Hypersocket單價相較於目前公司主流之AI/HPC測試基座coaxial socket高出30%)。

探針卡解決方案	Hypersocket
	

資料來源：穎崴

➢ 精測((6510)：強調AI in house之策略，發表智慧代理系統Agent P

精測展示AI探針卡、記憶體探針卡、AP探針卡，以及今年打入之新品Burn-in board等；另發表其自行開發之智慧代理系統Agent P，協助工程師在研發過程中之問題解決(可由資料庫進行模擬，協助工程師找到最佳解決方案)，以及透過該系統模擬從設計到採購全流程的各種風險情境(如提前預判是否缺料)，以此提供最佳化決策，甚至後續量產過程中協助新人應對問題並同步收集數據等。

本公司已針對報告內容力求正確，並為研究人員就其專業能力提供之善意分析，僅供投資人參考，本公司不負任何投資盈虧之法律責任，如引用本文，須經本公司同意。

SLT 板	Burn-in board
	

資料來源：精測

➢ **中砂(1560)：鑽石碟、再生晶圓為展出重點**

中砂業務部門包含ABU(砂輪事業部)、SBU(晶圓事業部)、DBU(鑽石事業部)。本次展覽重點落在後兩者，其中SBU部門中，公司展出6、8、12吋之再生晶圓，其中12吋月產能已達40萬片；另在DBU部門中，則可因應客戶訴求，提供各種鑽石碟產品，包含傳統鑽石碟、Coating鑽石碟、CVD鑽石碟和Pyradia鑽石碟等，其中Pyradia鑽石碟使用高強度鑽石，耐磨耗性佳。另在ABU部門中，公司則表示目前正在開發用於先進封裝之砂輪，期盼以此拓展新市場機會。

再生晶圓、氧化鋁晶圓	鑽石碟產品
	

資料來源：中砂

➢ **崇越(5434)：亮點則在於 CPO 應用、先進封裝散熱解決方案**

崇越為國內半導體材料代理商，可供應全製程所需之材料，本次展覽除了展出既有之代理產品，包含矽晶圓、方形矽基板、TGV基板與填充材等，以及自製之石英爐管；另展覽亮點則在於CPO應用、先進封裝散熱解決方案，前者公司與日本廠商Scivax合作，透過後者的專利奈米壓印技術，製作高密度微透鏡陣列以實現Micro LED的精準集光與高效率訊號耦合；另在散熱解決方案中，崇越則展出以微銅柱(Copper Pillar)陣列構建晶片微流道(Microchannel)的冷卻解決方案，可搭配高純度水或冷卻液在銅柱間流動並迅速帶走高溫熱能。

本公司已針對報告內容力求正確，並為研究人員就其專業能力提供之善意分析，僅供投資人參考，本公司不負任何投資盈虧之法律責任，如引用本文，須經本公司同意。

代理 Scivax 的 CPO、NPO 解決方案	採用 Microchannel 的 AI 晶片散熱模型
	

資料來源：崇越

➢ **家登(3680)：展出一系列先進製程、先進封裝載具**

家登提供先進製程、先進封裝、載板載具等一系列解決方案，其中家登的光罩載具具有抗靜電、充氣功能等以此避免靜電傷害並維護光罩潔淨度；晶圓載具中，公司本次展出耕耘多年之先進封裝載具，另因應日月光、力成FOPLP尺寸規格不同，公司也推出600*600、510*515mm²等個別之面板級封裝載具，另在載板載具中，隨著半導體後段材料朝向前段化發展，使得ABF潔淨度要求提升，故家登也提供對應之載具解決方案。而為打破過往美日廠商壟斷之載具市場，並因應新市場應用所需之載具方案，公司每年投入上億元研發費用，以此建立公司材料know-how。

光罩傳載解決方案	先進封裝傳載解決方案
	

資料來源：家登

➢ **迅得(6438)：展示新推出應用於面板級封裝的Dual-arm Panel EFEM雙臂載板上下料機**

迅得展出應用於面板級封裝的Dual-arm Panel EFEM 雙臂載板上下料機，在收放料的過程中，該設備可搭配AOI進行即時外觀檢驗，系統能先初步篩檢是否有嚴重翹曲，避免問題基板流入後續製程。在面板級封裝的製程中，大尺寸玻璃臨時載具在搬運過程中極易因晃動或撞擊而破裂，如何維持搬運平穩、降低玻璃破損率是關鍵，技術核心機械手臂是由台灣研發團隊完全自主設計、開發與控制，優勢在於能高度掌控手臂運動時的抑震與微幅震動調校，進而保障極為脆弱的大面積玻璃基板在高速搬運時的安全性。目前晶圓龍頭廠與日月光都跟迅得緊密配合，針對不同的基板尺寸進行共同研發與測試。

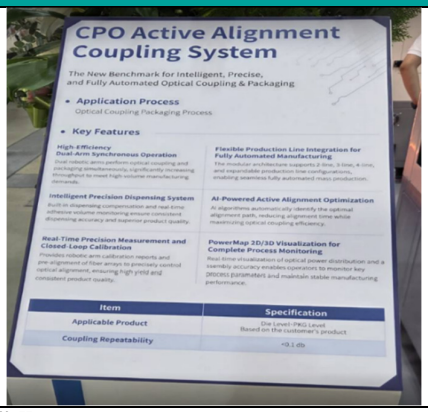
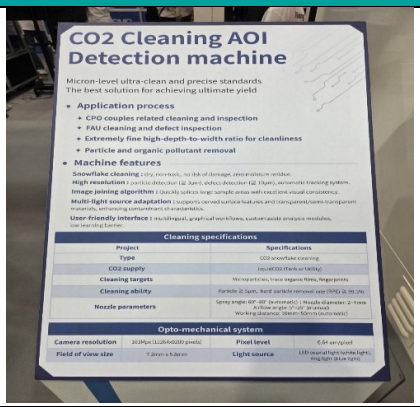
本公司已針對報告內容力求正確，並為研究人員就其專業能力提供之善意分析，僅供投資人參考，本公司不負任何投資盈虧之法律責任，如引用本文，須經本公司同意。

Dual-arm Panel EFEM 雙臂載板上下料機實體	Dual-arm Panel EFEM 雙臂載板上下料機規格
	

資料來源：迅得

➢ **萬潤(6187)：展示六軸高精度FAU耦合對位設備與針對FAU清潔的液態二氧化碳清潔設備**

萬潤展出針對CPO製程的兩大核心設備，包含六軸高精度FAU耦合對位設備與針對FAU清潔的液態二氧化碳清潔設備(結合AOI)，由於FAU耦合需要應對三維空間中的多維角度公差，傳統只走XY軸與高度的對位已無法滿足需求，採用六軸機構控制能執行更為複雜、具備立體感的細微角度(如細部旋轉與傾斜)調校，以達到最佳對位，標準製程流程:耦合對位>光通量測試>UV固化，整體製程速度較慢，主要係因對位與測試光量需要時間較長，UPH的高低很大程度也取決於選用的膠水固化時間。在FAU與PIC進行耦合對位前，使用液態二氧化碳清潔，利用超低溫讓表面的油污或微粒瞬間凍結結冰，再利用高速高壓的氣體動能將其吹離表面，進行設備串聯時，可以採用1台液態二氧化碳清潔設備搭配數台耦合對位設備的模式運作。

六軸高精度 FAU 耦合對位設備	FAU 液態二氧化碳清潔設備
	

資料來源：萬潤

➢ **盟立(2464)：展示OHT空中走行式搬送系統、諧波減速機及關節零組件**

盟立子公司盟英科技展出設計諧波減速機及關節零組件，可應用於人形機器人或傳統機械手臂，依部位荷重需求選用不同扭矩等級的諧波減速機與關節模組，跟盟立進行搭配，除了適用於工廠巡檢或保全的機器人，也應用於餐廳常見的點餐/送餐服務型機器人。盟立展出OHT空中走行式搬送系統(天車)，目前在台灣的天車系統是以後段先進封裝以及載板廠為大宗，前段晶圓製造廠亦有部分導入(主要在海外廠商)，因為前段製程道數極多，天車的搬運頻率極高，對台車控制的穩定度、可靠度要求更高。展場中亦

本公司已針對報告內容力求正確，並為研究人員就其專業能力提供之善意分析，僅供投資人參考，本公司不負任何投資盈虧之法律責任，如引用本文，須經本公司同意。

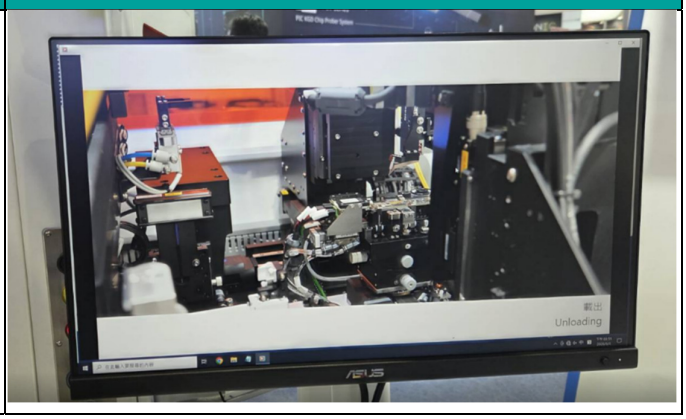
展示了盟立的面板級封裝相關設備(該設備已實際導入客戶端)，支援310mm×310mm與510mm×515mm尺寸。

人形機器人解決方案	人形機器人關節模組
	

資料來源：盟立

- **惠特(6706)：展出矽光子耦光貼合機**

惠特展出矽光子耦光貼合機，設備搭配六軸高精度機構進行對準，此款設備採用駿河精機模組，雖然物理精度相較於德國 PI(Physik Instrumente)微幅下降，但對後段封裝對位而言已完全足夠，其最大的優勢在於負重能力強，承重極限可達200~250克，能穩定吊掛較重、較複雜的光學治具而不會產生位移。目前CPO元件的主動對位、點膠到固化的整體時間大約需要4~6分鐘，現場展示的機台在今年已經開始正式出貨給客戶，目前仍處於研發設備驗證與概念測試階段，全球尚無任何客戶進入真正的CPO設備量產線建置，惠特與大立光、台積電等一線指標大廠維持非常緊密的聯繫與互動。

矽光子耦光貼合機	矽光子耦光貼合機內部機構
	

資料來源：惠特

- **合晶(6182)：展出SOI Wafer及GaN Epi產品**

本次展出I-SOI、B-SOI、M-SOI、S-SOI、C-SOI及Epi-SOI、GaN等產品，尺寸涵蓋150mm、200mm至300mm，主要應用聚焦HPC與矽光子、功率/無線通訊，及智慧感測與MEMS領域。其中，以Semipolar GaN核心專利技術，透過SOI基底、V形槽氣相蝕刻、半極性GaN定向生長，全應力鬆弛與集成技術，為矽光子技術佈局。隨AI推動高速傳輸與低功耗互連需求攀升，SOI能對應矽光子技術平衡；另GaN產品，可滿足資料中心及高壓產品如800V需求，其優點在於電轉換效率相對矽材料更好。

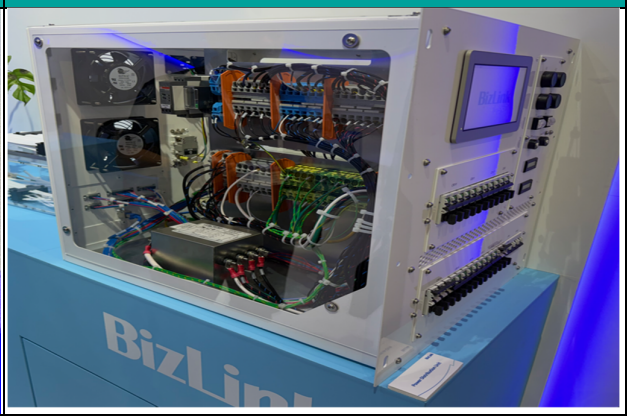
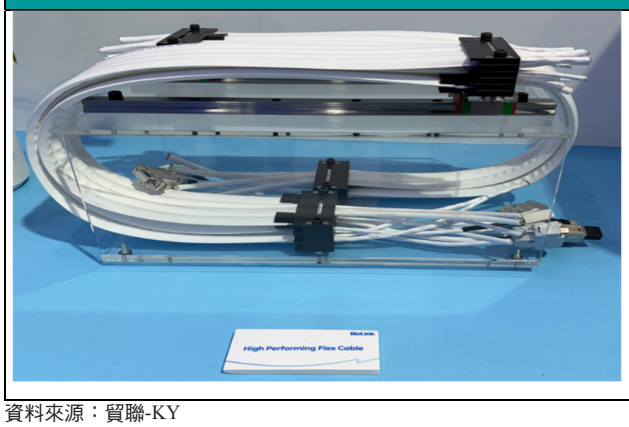
本公司已針對報告內容力求正確，並為研究人員就其專業能力提供之善意分析，僅供投資人參考，本公司不負任何投資盈虧之法律責任，如引用本文，須經本公司同意。

GaN Epi on S.I-SiC 與 GaN Epi on SOI	SOI Wafer
	

資料來源：合晶

➢ **貿聯-KY(3665)：展示半導體設備Box Build與系統整合方案**

本次展出高精密半導體設備，涵蓋Box Build、系統整合及客製化互連系統等領域以及產品，其中隨半導體製程由N5/N4轉換至N3/N2，製程複雜度大幅提升，貿聯-KY提供EDS(Electricity Distribution Systom)和FDS(Fluid Distribution Systom)等產品予美系半導體設備客戶。另外，因應半導體設備及超高真空 (UHV)應用環境設計的客製化線纜與互連系統，採用高效能、低排放線纜組件，可滿足嚴苛的半導體應用需求。

Power Distrubution Unit(正面)	Power Distrubution Unit(側面)
	
High Performance Flex Cable	**Fluid Distribution Unit**
	

資料來源：貿聯-KY

本公司已針對報告內容力求正確，並為研究人員就其專業能力提供之善意分析，僅供投資人參考，本公司不負任何投資盈虧之法律責任，如引用本文，須經本公司同意。

玉山投顧
E.SUN Investment Consulting

2026/9/4

Semicon建議聚焦投資組合

股票代號	公司名稱	09/03 收盤價(元)	營收(億元)			EPS(元)		2027年 本益比
			2026(F)	2027(F)	YoY	2026(F)	2027(F)	
6515	穎崴	7,000	161.3	28.9	78.9%	100.91	213.54	32.8
6510	精測	3,350	69.1	109.0	57.8%	58.99	103.05	32.5
1560	中砂	711	102.7	123.6	20.4%	14.49	19.76	36.0
5434	崇越	527	888.3	1,058.2	19.1%	30.54	34.98	15.1
2360	致茂	2,015	529.7	745.8	40.8%	42.9	59.92	33.6
7769	鴻勁	5,870	542.8	929.7	71.3%	125.66	215.52	27.2
3131	弘塑	2,365	83.4	122.7	47.1%	62.1	102.1	23.2
3583	辛耘	742	124.1	151.6	22.1%	19.26	29.2	25.4
6187	萬潤	1,300	90.6	129.6	43.1%	28.96	40.21	32.3
6937	天虹	278	30.3	40.3	33.0%	6.4	10.15	27.4
7734	印能	2,710	41.4	58.3	40.7%	64.86	89.36	30.3
6640	均華	1,185	39.6	62.6	58.0%	21.83	40.21	29.5
2467	志聖	595	108.4	137.0	26.4%	15.11	21.04	28.3
7751	竑騰	1465	33.8	75.8	124.0%	36.85	90.19	16.2
6182	合晶	104.5	962.4	1,052.6	9.36%	0.44	5.41	19.3
3665	貿聯-KY	2,100	1,022.3	1,379.3	34.9%	67.27	104.63	20.1

本公司已針對報告內容力求正確，並為研究人員就其專業能力提供之善意分析，僅供投資人參考，本公司不負任何投資盈虧之法律責任，如引用本文，須經本公司同意。

玉山證券投資顧問股份有限公司（以下簡稱「玉山投顧」）為玉山金融事業群之成員。

研究報告可自本公司網站(www.esunconsulting.com.tw)取閱。

研究人員聲明

研究人員聲明無任何其個人報酬來自於本研究報告的建議或觀點。

免責聲明

玉山投顧已針對報告內容力求正確，並為研究人員就其專業能力提供之善意分析，財務預估及投資評等係就報告發行當時，所收集之資訊進行合理之判斷，日後若有資訊更新，玉山投顧將不針對此報告出具更新通知。本報告僅供投資人參考，玉山投顧不負任何投資盈虧之法律責任，如引用本文，須經本公司同意。

智慧財產權聲明

本資料各項內容之各項權利及智慧財產權（包括但不限於著作權、專利權、商標權等）均屬玉山投顧所有。除非獲得玉山投顧事前書面同意外，均不得擅自以任何形式複製、重製、修改、發行、上傳、張貼、傳送、散佈、公開傳播、販售或其他非法使用本資料。除非有明確表示，本資料之提供並無明示或暗示授權貴方任何著作權、專利權、商標權、商業機密或任何其他智慧財產權。